

Dane o produkcie



ID produktu 5893

Nazwa produktu Kompaktowy hybrydowy piec rozpliwowy Martin MINIOVEN 05

Numer katalogowy 809036

Producent MARTIN

Opis

MINIOVEN jest kompaktowym i wytrzymałym urządzeniem stołowym, które zostało specjalnie opracowane do reballingu komponentów BGA i wstępnego lutowania chipów QFN. Urządzenie wykorzystywane jest zarówno w fazie rozwoju jak i produkcji. Wydajna hybrydowa technologia grzewcza podgrzewa elementy elektroniczne równomiernie ze wszystkich stron, gwarantując w ten sposób powtarzalne wyniki reballingu. Intuicyjna nawigacja po menu umożliwia tworzenie, zarządzanie i zapisywanie do 25 profili lutowania. Po raz pierwszy zastosowano dodatkowy, zewnętrzny czujnik temperatury, aby zapewnić najwyższą możliwą niezawodność podczas automatycznego uczenia profili reballingu. Za jego pomocą określone są optymalne parametry profilu dla osiągnięcia określonej temperatury komponentu.

Oprogramowanie EASYBEAM PC pozwala wygodnie edytować profile reballingu i wyświetlać zmiany temperatury.

Oprócz reballingu komponentów BGA dostępne są uchwyty komponentów i urządzenia do wstępnego lutowania komponentów QFN. Urządzenie posiada przyłącze do gazu procesowego. Oznacza to, że procesy rozpliwowe można łatwo przeprowadzać w atmosferze azotu.

Moc: 500W

Wymiary dł. x szer. x wys.:	150x300x85mm
Wymiary elementu grzejnego:	105x130mm
Zakres temperatury:	50-250°C
Czujniki:	1 x zainstalowany na stałe wewnątrz + 1 x wolny na zewnątrz
Ilość profili:	25.
Rozmiar komponentu:	maks. 55 x 55 x 4 mm

- zoptymalizowana dystrybucja ciepła poprzez konwekcję
- nadaje się do stosowania pasty lutowniczej lub kulek lutowniczych
- kompaktowy format, innowacyjny design i intuicyjna obsługa
- możliwość zastosowania azotu w procesie lutowania
- korzystanie z profili temperaturowych za pomocą oprogramowania komputerowego